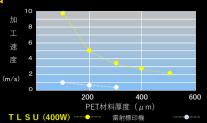


全新領域

1. 切割速度更快

切割速度約10倍

TLSU系列的雷射發振 器由於功率大,加工時 間比雷射標印機更快速。



2. 加工定位精度更高

加工定位精度約10倍

TLSU系列以數位式2次元檢流 計掃描器進行雷射光掃描,加 工定位精度比雷射標印機更精 淮



使用檢流計掃描器的加工例

3. 適用材料越多,切割厚度越厚

可處理以前無法加工的材料或厚度

在雷射標印機的功率下難以加工的材料或厚度,TLSU系列也能以高功率雷射進行切割加工。



玻璃纖維膜片沖孔

4. 配合搬運速度加工

可自動配合搬運速度調整加工形狀

TLSU系列可匯入搬運裝置編碼器的 搬運速度資料,在雷射切割時自動 調整加工形狀。 (外加功能)



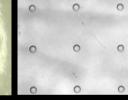
搬運中加工示意

加工例

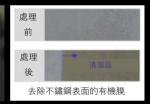












切割不織布

切割黏膠布

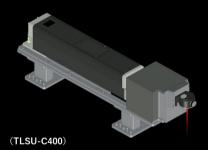
複合膜片的半層加工

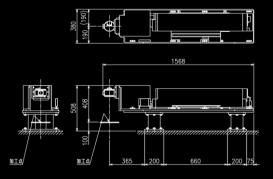
樹脂膜片沖孔

標印

去除金屬表面膜層

外形尺寸圖 [單位mm]





主要規格

光學類

型號

TLSU-C100 /-C200 /-C350 /-C400

切割雷射	雷射種類	RF激勵二氧化碳雷射 波長10.6μm或9.4μm/等級4
	發振模式	單頻式 M2 <1.2
	額定功率	100W \sim 350W (9.4 μ m) / 400W (10.6 μ m)
	重複頻率	~200kHz
	冷卻方式	水冷 (循環冷卻能力<8.7kw 使用精製水)
	方式	數位式XY軸檢流計掃描反射鏡
檢流計掃描	重複定位精度	12 µ rad以下
器	雷射光掃描速度	最快3000mm/sec以上
一般規格		
輸入電壓		三相 AC210V±5%
消費電力(加工中)		25kW
耐用環境	周遭環境溫度	20∼30°C
	周遭環境濕度	RH70%以下 無結露
機台重量		約360kg
附帶設備		控制盤、冷卻機、雷射電源、吹氣裝置3件組合面板
設置條件		無有毒氣體、水滴、油分、電磁波及震動之室內
匯入資料		
電腦硬碟容量		320G
外部連接		USB
輸入內容	設定值	雷射功率、加工速度、重複頻率
	圖形	CAD (DXF)